

证券代码：300735

证券简称：光弘科技

公告编号：2023-021 号

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度概况

为满足公司生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，2023 年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向银行申请总额不超过 30 亿元（含等值外币）的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及其下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司授权董事长及相关人员在上述授信额度内代表公司签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

二、对公司的影响

公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括全资子公司及控股子公司）生产经营和发展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了

《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）2023 年度拟向银行申请总额不超过 30 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度。同时授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）2023 年度向银行申请总额不超过 30 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日